

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60191-2

AMENDEMENT 8
AMENDMENT 8
2003-06

Amendement 8

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –**

**Partie 2:
Dimensions**

Amendment 8

**Mechanical standardization of semiconductor
devices –**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans la
Publication 60191-2*

*The sheets contained in this amendment are to be
inserted in Publication 60191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

J

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 60191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page de titre.

Retirer la page 60191 IEC I existante contenant la préface et la remplacer par la nouvelle page 60191 IEC I contenant la préface à l'amendement 8 (2003).

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

60191 IEC I-166E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 60191-2

Replace the existing title page with the new title page.

Remove the existing page 60191 IEC I containing the preface and insert in its place the new page 60191 IEC I containing the preface to Amendment 8 (2003).

Chapter I:

Add the following new sheets:

60191 IEC I-166E - a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC
60191-2**

Première édition
First edition
1966

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974), F (1976),
G (1978), H (1978), J (1980), K (1981), L (1982), M (1983),
N (1987), P (1988), Q (1990), R (1995), S (1995), T(1995),
U(1997), V(1998), W(1999), X(1999), Y(2000), Z(2000)
et/and Amendement/Amendment 1 (2001), 2(2001), 3(2001),
4(2001), 5(2002), 6(2002), 7(2002), 8(2003)

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs –

Partie 2: Dimensions

Mechanical standardization of semiconductor devices –

Part 2: Dimensions

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite
ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

**NORMALISATION MÉCANIQUE
DES DISPOSITIFS À
SEMICONDUCTEURS**

DEUXIÈME PARTIE: DIMENSIONS

SOMMAIRE

PRÉAMBULE	
PRÉFACE	
CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE	Chapitre 00
VALEURS RECOMMANDÉES POUR CER- TAINES DIMENSIONS DE DESSINS DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS.....	Chapitre 0
DESSINS D'ENCOMBREMENTS.....	Chapitre I
TYPES DE DISPOSITIFS À SEMICONDUCT- EURS GÉNÉRALEMENT MONTÉS DANS LES BOÎTIERS DU CHAPITRE I	
DESSINS D'EMBASES.....	Chapitre II
DESSINS DE BOÎTIERS	Chapitre III
DESSINS DE CALIBRES	Chapitre IV
TABLEAUX MONTRANT LES ASSOCIA- TIONS ENTRE LES BOÎTIERS ET LES EMBASES	Chapitre V
DESSINS OBSOLÈTES	
COMPLÉMENTS AUX LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DES NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	
SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CODES NATIONAUX FIGURANT SUR LES FEUILLES DE NORMES DE LA PUBLICATION 191-2 DE LA CEI	

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PUBLICATION 191-2

**MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR
DEVICES**

PART 2: DIMENSIONS

CONTENTS

FOREWORD	
PREFACE	
PHILOSOPHY OF MECHANICAL STAN- DARDIZATION	Chapter 00
RECOMMENDED VALUES FOR CERTAIN DIMENSIONS OF DRAWINGS OF SEMI- CONDUCTOR DEVICES	Chapter 0
DEVICE OUTLINE DRAWINGS	Chapter I
TYPES OF SEMICONDUCTOR DEVICES GENERALLY MOUNTED IN THE PACKAGES OF CHAPTER I	
BASE DRAWINGS.....	Chapter II
CASE OUTLINE DRAWINGS.....	Chapter III
GAUGE DRAWINGS	Chapter IV
TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BE- TWEEN CASE OUTLINES AND BASES.....	Chapter V
OBSOLETE DRAWINGS	
ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	
DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL CODES APPEARING ON THE STANDARD SHEETS OF IEC PUBLICATION 191-2	

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Amendement 8 (2003) à la CEI 60191-2 (1966)

**NORMALISATION MÉCANIQUE DES DISPOSITIFS
À SEMICONDUCTEURS –****Partie 2: Dimensions**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

PRÉFACE À L'AMENDEMENT 8 (2003)

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47D: Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47D/532/FDIS	47D/547/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Amendment 8 (2003) to IEC 60191-2 (1966)

**MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES –****Part 2: Dimensions**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

PREFACE TO AMENDMENT 8 (2003)

This amendment has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical standardization of semiconductor devices of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47D/532/FDIS	47D/547/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

CHAPITRE 00 – CONCEPTION DE LA NORMALISATION MÉCANIQUE

1. Règles fondamentales

Lors de la réunion tenue à Montreux (juin 1981), le Comité d'Etudes n° 47 adopta les règles fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées à Copenhague en octobre 1962:

- A. Toute proposition nouvelle devra être soumise à l'étude préliminaire d'un groupe de travail convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.
- B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs suivants:
 - 1. Aboutir à une normalisation active en n'acceptant que les boîtiers qui sont soutenus internationalement.
 - 2. Spécifier de façon précise les dimensions en vue d'assurer l'interchangeabilité et de faciliter les manipulations automatiques.
 - 3. Reconsidérer continuellement les dessins existants et proposer la suppression de ceux qui ne sont plus soutenus.
- C. Il ne sera procédé à la discussion d'un dessin de boîtier que s'il a le soutien préalable d'au moins trois pays.
- D. Un dessin ne sera introduit dans la Publication 191-2 de la CEI que si au moins trois des pays qui le soutiennent ont fourni leur numéro de code national (ou exprimé un soutien formel s'ils ne possèdent pas de numéro de code).

Notes 1. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Orlando (février 1980), il a été admis d'étendre le domaine d'activité du GT7 de façon qu'il couvre aussi bien la normalisation mécanique des semiconducteurs discrets que celle des circuits intégrés.

Il a été également admis que, compte tenu de l'élargissement de son domaine d'activité, le GT7 serait le groupe de travail qualifié mentionné dans le paragraphe A.

En vue d'éviter que l'introduction du GT7 dans le processus suivi par le Comité d'Etudes n° 47 pour préparer des documents secrétariat sur la normalisation mécanique provoque des délais supplémentaires, le GT7 a été autorisé à obtenir de la part des trois pays concernés, ou plus, la confirmation directe du maintien de leur appui pour ces propositions.

- 2. – Lors de la réunion du Comité d'Etudes n° 47 à Montreux (juin 1981), il a été admis que les réunions du GT7 s'intégreraient dans les réunions du Comité d'Etudes n° 47.

Cependant, certaines propositions peuvent nécessiter un temps d'études dépassant la durée d'une réunion du Comité d'Etudes n° 47 et en conséquence requérir une ou plusieurs réunions du GT7 entre deux réunions consécutives du Comité d'Etudes n° 47.

Lors de la réunion tenue à Moscou (juin 1977), le Comité d'Etudes n° 47 adopta la règle suivante:

Lorsqu'un dessin de la Publication 191-2 de la CEI vient à ne plus être soutenu que par un seul pays, il sera retiré de la publication principale et transféré dans une section séparée intitulée «Dessins obsolètes» avec l'indication de la date de transfert sur la feuille particulière correspondante.

Un avertissement au début de la section dévolue aux dessins obsolètes stipulera qu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf s'il est soutenu par un autre pays dans l'intervalle.

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)			
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(Etats-Unis)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2000
150E		I-150E	2002
151E		I-151E	2002
152E		I-152E	2002
153E		I-153E	2002
154E		I-154E	2001
155E		I-155E	2001
157E		I-157E	2001
158E		I-158E	2002
159E		I-159E	2002
160E		I-160E	2001
161E		I-161E	2001
162E		I-162E	2001
163E		I-163E	2002
164E		I-164E	2001
165E		I-165E	2002
166E		I-166E	2003
Forme F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)			
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
116E01	SC-529-14BA	I-116E	1988
116E02	SC-530-16CA		
116E03	SC-531-20AA		
117E01	SC-530-16BA	I-117E	1988
117E02	SC-531-20BA		
117E03	SC-532-24AA		
117E04	SC-533-28AA		
117E05	SC-533-28BA		
118E01	SC-532-24BA	I-118E	1988
118E02	SC-533-28CA		
119E02	(USA)	I-119E	1990
119E03			
120E	NT194	I-120E	1990
121E	NT213	I-121E	1994
122E	NT221	I-122E	1994
123E		I-123E	1997
129E	NT223	I-129E	1994
133E		I-133E	2000
134E		I-134E	2000
135E		I-135E	2000
136E		I-136E	2000
137E		I-137E	2000
138E		I-138E	
139E		I-139E	
140E		I-140E	1999
141E		I-141E	1999
142E		I-142E	1998
143E		I-143E	1998
144E		I-144E	1999
147E		I-147E	1999
148E		I-148E	1999
149E		I-149E	2002
150E		I-150E	2002
151E		I-151E	2002
152E		I-152E	2002
153E		I-153E	2002
154E		I-154E	2001
155E		I-155E	2001
157E		I-157E	2001
158E		I-158E	2002
159E		I-159E	2002
160E		I-160E	2001
161E		I-161E	2001
162E		I-162E	2001
163E		I-163E	2002
164E		I-164E	2001
165E		I-165E	2002
166E		I-166E	2003
Form F			
084F		I-084F	1996
100F		I-100F	1990
101F01	101F01	I-101F	1998
101F01	101F01		
102F		I-102F	1998
102F0	102F01		
102F02	102F02		
102F033	102F03		

CHAPITRE I – DESSINS D'ENCOMBREMENTS

Liste des dessins <i>(suite)</i>			
Numéro de code CEI	Code du pays d'origine	Numéro de page et date	
Forme G			
050G01	SO5-87D	I-50a/b/c/d	1985
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F		
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Suède)		
050G16	A1AA	I-50e	1990
050G17	A1AB		
050G18	A1BA		
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

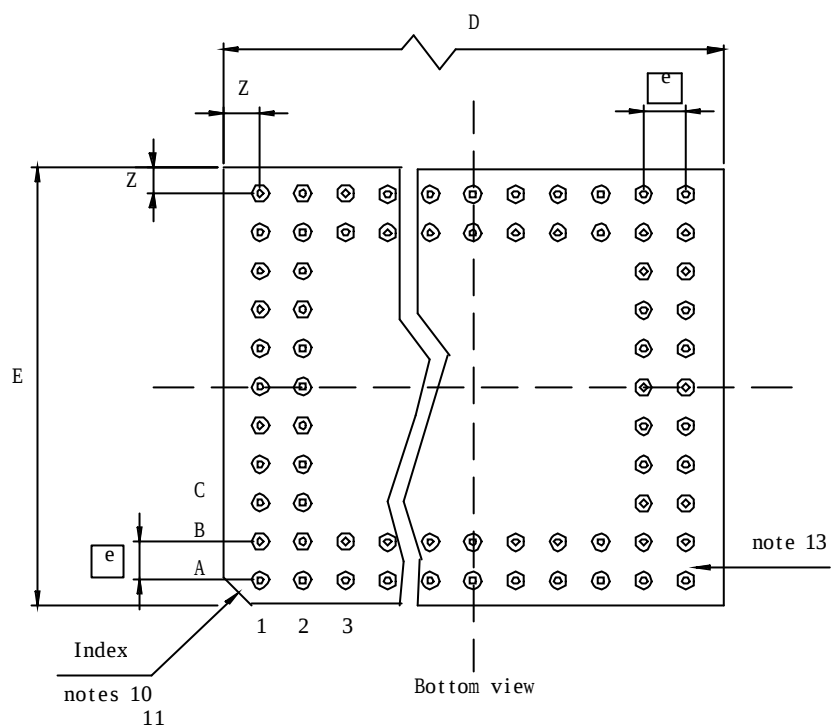
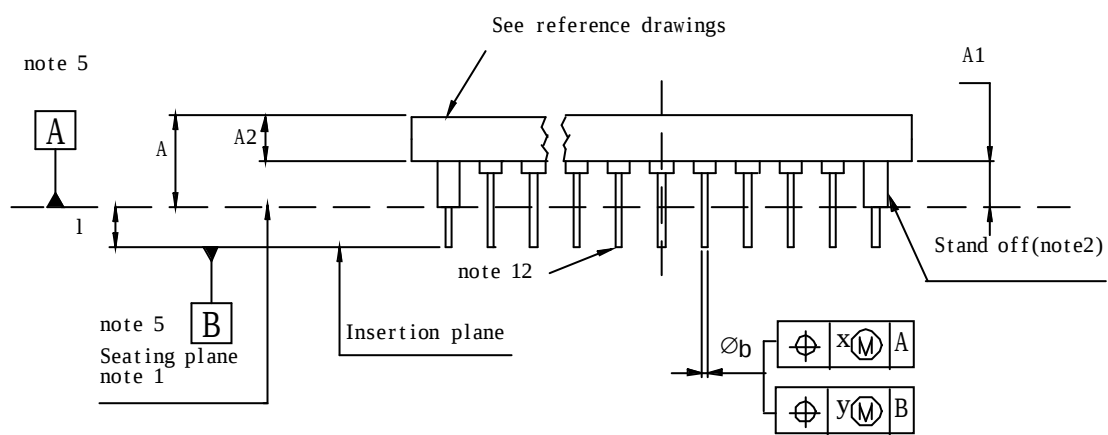
CHAPTER I – DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings <i>(continued)</i>			
IEC code number	Code of country of origin	Page number and date	
Form G			
050G01	SO5-87D	I-50a/b/c/d	1985
050G02	SO-188D		
050G03	SO-87A		
050G04	SO-87B		
050G05	SO-188A		
050G06	SO-188B		
050G07	SO-188F		
050G08	SO-87C		
050G10	SO-188C		
050G11	SO505-18A		
050G12	SO-87G		
050G13	SO-188E		
050G14	(Sweden)		
050G16	A1AA	I-50e	1990
050G17	A1AB		
050G18	A1BA		
050G19	A1BB		
050G20	A1CB		

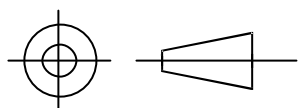
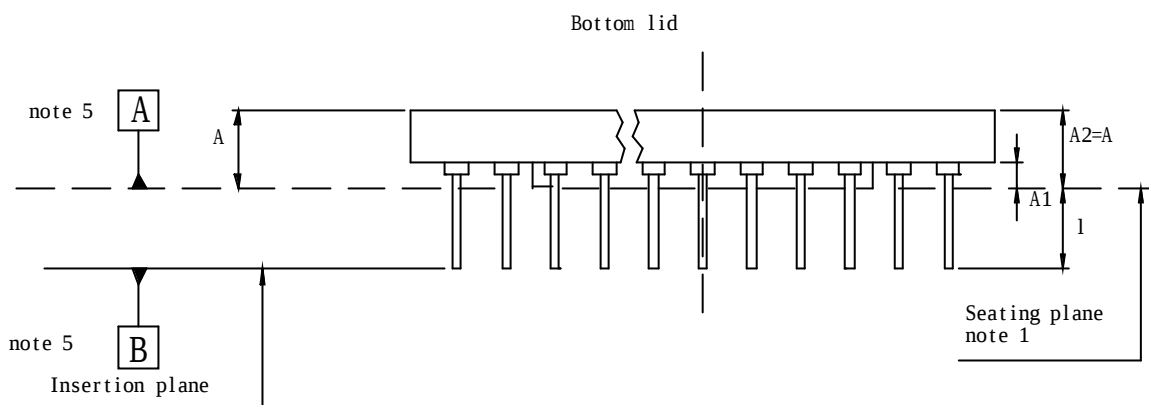
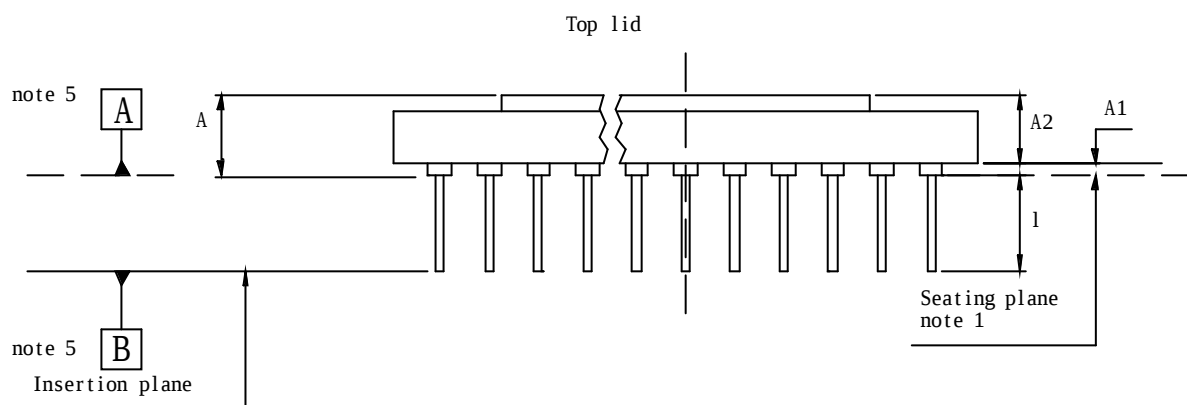
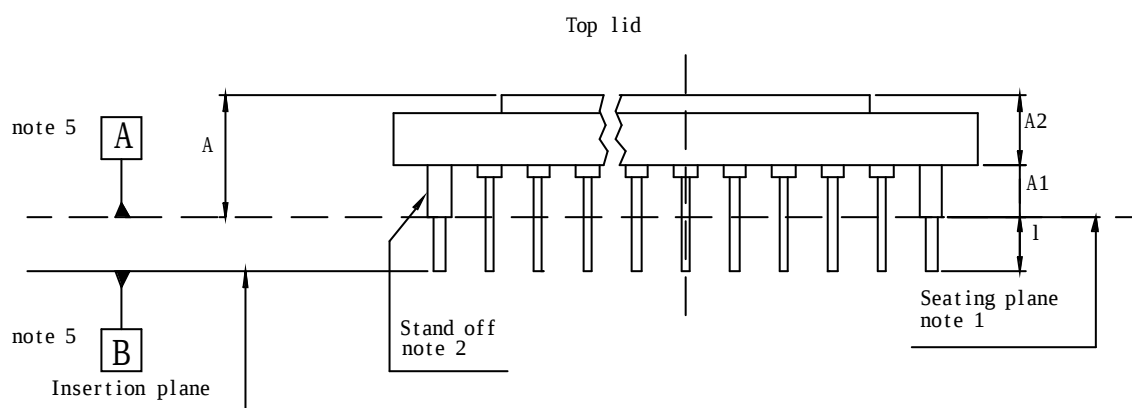
Types de dispositifs à semiconducteurs
généralement montés dans les boîtiers
du chapitre I de la CEI 60191-2

Types of semiconductor devices
generally mounted in the packages
of chapter I of IEC 60191-2

Type de dispositif Type of device	Numéro de code CEI du dessin du boîtier IEC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Signal diodes and small-power Zener diodes	A1, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69, A70, A71, 098H, 100H
Diodes hyperfréquences Microwave diodes	A18
Diodes de redressement de faible et moyenne puissance Rectifier diodes, small and medium power	A2, A3, A4, A6, A7, A19, A37, A44, A74, 077B, 100B
Diodes de redressement de forte puissance High-power rectifier diodes	A8, A9, A10, A15, A16, A17, A21, A22, A35, 083B, 103B
Thyristors de faible et moyenne puissance Thyristors, small and medium power	A11, A13, A14, A38, A43
Thyristors de forte puissance High-power thyristors	A12, A27, A28, A29, A34, A39, A47, 104B, 105B
Transistors de signal Signal transistors	A36, A40, A41, 068A, 046E, 114E
Transistors de puissance Power transistors	A23, A30, A31, A43, A48, A56, A57, A45, A73, 080B, 081B, 082B, 101B, 102B, 102F, 120E, 084F, P100F
Transistors hyperfréquences Microwave transistors	A26, A42, A43, A59, A66, A72, 100C
Dispositifs optoélectroniques Optoelectronic devices	A62, A64, A65, A63A, 100A, 101A, 106B, 107B
Circuits intégrés Integrated circuits	A52, A53, A61, 075E, 076E, 099E, 100E, 102E, 112E, 115E, 116E, 117E, 118E, 119E, 121E, 122E, 123E, 129E, 133E, 134E, 135E, 136E, 137E, 138E, 139E, 140E, 141E, 144E, 147E, 148E, 149E, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E, 155E, 157E, 158E, 159E, 160E, 161E, 162E, 163E, 164E, 165E, 166E, 050G, 051G, 060G, 100G, 101G



	PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH OUTLINE FAMILY	Date: 2003
	60191 IEC I - 166E-a	



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

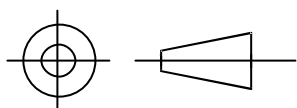
Date: 2003

60191 IEC I – 166E-b

Dimensions to be specified.

Table A: Dimensions common to all types of pin grid array packages
Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Ref.	Millimeters (note 14)			Notes
	min.	nom.	max.	
A	2.45	-	6.05	1,2
A1	0.65	-	-	3
A2	-	-	4.55	3
Ø b	0.40	-	0.60	4
	-	2.54	-	
l	2.54	-	5.08	1
x	-	-	0.25	5
y	-	-	0.25	5
z	-	-	2.54	6



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

Table B: Type specific dimensions

Millimeters note 14

Ref.	E 1			E 2			E 3			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	24.40	-	27.90	24.40	-	27.90	26.95	-	30.45	
E	24.40	-	27.90	24.40	-	27.90	26.95	-	30.45	
nD	-	10	-	-	10	-	-	11	-	7
nE	-	10	-	-	10	-	-	11	-	8
n	-	64	-	-	68	-	-	68	-	9,10
Pin arrangement	Fig. 1			Fig. 2			Fig. 3			

Millimeters note 14

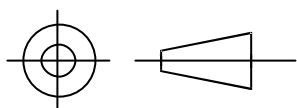
Ref.	E 4			E 5			E 6			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	26.95	-	30.45	26.95	-	30.45	26.95	-	30.80	
E	26.95	-	30.45	26.95	-	30.45	26.95	-	30.80	
nD	-	11	-	-	11	-	-	11	-	7
nE	-	11	-	-	11	-	-	11	-	8
n	-	69	-	-	73	-	-	85	-	9,10
Pin arrangement	Fig. 4			Fig. 5			Fig. 6			

Millimeters note 14

Ref.	E 7			E 8			E 9			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	30.20	-	30.80	29.50	-	33.00	32.00	-	35.55	
E	30.20	-	30.80	29.50	-	33.00	32.00	-	35.55	
nD	-	12	-	-	12	-	-	13	-	7
nE	-	12	-	-	12	-	-	13	-	8
n	-	84	-	-	107	-	-	88	-	9,10
Pin arrangement	Fig. 7			Fig. 8			Fig. 9			

Millimeters note 14

Ref.	E 10			E 11			E 12			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	32.00	-	35.55	32.00	-	35.55	32.00	-	35.55	
E	32.00	-	35.55	32.00	-	35.55	32.00	-	35.55	
nD	-	13	-	-	13	-	-	13	-	7
nE	-	13	-	-	13	-	-	13	-	8
n	-	101	-	-	120	-	-	121	-	9,10
Pin arrangement	Fig. 10			Fig. 11			Fig. 12			

PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

60191 IEC I - 166E-d

Millimeters note 14

Ref.	E 13			E 14			E 15			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	34.55	-	38.10	34.55	-	38.10	34.55	-	38.10	
E	34.55	-	38.10	34.55	-	38.10	34.55	-	38.10	
nD	-	14	-	-	14	-	-	14	-	7
nE	-	14	-	-	14	-	-	14	-	8
n	-	132	-	-	133	-	-	135	-	9.10
Pin arrangement	Fig. 13			Fig. 14			Fig. 15			

Millimeters note 14

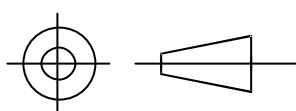
Ref.	E 16			E 17			E 18			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	37.80	-	38.50	39.60	-	40.40	37.10	-	40.60	
E	37.80	-	38.50	39.60	-	40.40	37.10	-	40.60	
nD	-	15	-	-	15	-	-	15	-	7
nE	-	15	-	-	15	-	-	15	-	8
n	-	144	-	-	145	-	-	177	-	9.10
Pin arrangement	Fig. 16			Fig. 17			Fig. 18			

Millimeters note 14

Ref.	E 19			E 20			E 21			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	37.10	-	40.60	42.20	-	45.70	42.20	-	45.70	
E	37.10	-	40.60	42.20	-	45.70	42.20	-	45.70	
nD	-	15	-	-	17	-	-	17	-	7
nE	-	15	-	-	17	-	-	17	-	8
n	-	179	-	-	209	-	-	225	-	9.10
Pin arrangement	Fig. 19			Fig. 20			Fig. 21			

Millimeters note 14

Ref.	E 22			E 23			E 24			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	42.20	-	45.70	42.20	-	45.70	36.70	-	47.80	
E	42.20	-	45.70	42.20	-	45.70	36.70	-	47.80	
nD	-	17	-	-	17	-	-	18	-	7
nE	-	17	-	-	17	-	-	18	-	8
n	-	225	-	-	240	-	-	223	-	9.10
Pin arrangement	Fig. 22			Fig. 23			Fig. 24			



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

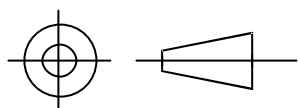
60191 IEC I - 166E-e

Millimeters note 14

Ref.	E 25			E 26			E 27			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	45.20	-	46.20	47.25	-	50.80	47.25	-	50.80	
E	45.20	-	46.20	47.25	-	50.80	47.25	-	50.80	
nD	-	18	-	-	19	-	-	19	-	7
nE	-	18	-	-	19	-	-	19	-	8
n	-	224	-	-	257	-	-	281	-	9,10
Pin arrangement	Fig. 25			Fig. 26			Fig. 27			

Millimeters note 14

Ref.	E 28			E 29			E 30			Notes
	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
D	49.80	-	53.30	49.80	-	53.30	55.30	-	56.40	
E	49.80	-	53.30	49.80	-	53.30	55.30	-	56.40	
nD	-	20	-	-	20	-	-	22	-	7
nE	-	20	-	-	20	-	-	22	-	8
n	-	257	-	-	299	-	-	340	-	9,10
Pin arrangement	Fig. 28			Fig. 29			Fig. 30			


 P INGRID ARRAY 2,54 mm PITCH
 OUTLINE FAMILY

Date: 2003

60191 IEC I - 166E-f

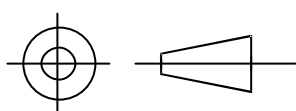
Notes

- 1 - Seating plane: the seating plane is determined when the device terminals are fully inserted into holes of diameter of 1,1 mm the centres of which are located on a grid matrix with $\frac{e}{2}$ / $\frac{e}{2}$ as modulus.
- 2 - Stand-offs are optional, but when present they should be located on the pin matrix diagonals.
- 3 - Dimension A2 includes both the package body and lid for either lid up or lid down configuration. (See reference drawings.)
- 4 - Dimension $\varnothing b$ includes solder dip supplementary thickness. If not, solder dip detailed specification shall give both $\varnothing b$ diameter without and with solder.
- 5 - Positional tolerance per ISO Standard 1101.
 - x value applies at datum A (deviation from the theoretical position),
 - y value applies at datum B (deviation from the theoretical position).
- 6 - Package overhang Z

either $Z < \frac{e}{2}$

or $\frac{e}{2} \leq Z < e$

Package drawings which differ by their overhang only may be differentiated by a suffix in their code number.
- 7 - nD is the number of terminal columns of the matrix in the D direction.
- 8 - nE is the number of terminal rows of the matrix in the E direction.
- 9 - n is the maximum possible number of terminals.
- 10 - Terminal number designation shall be in accordance with Appendix C of IEC 60191-3.



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

60191 IEC I – 166E-g

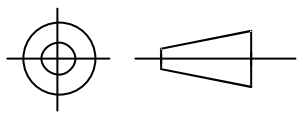
11 - Mechanical index (e.g. corner) is optional, but some visual identification shall appear on both top and bottom of the package.

When in addition to the visual identification, a supplementary mechanical index, intended to avoid miss-orientation at insertion, is either a supplementary terminal or a missing terminal, then the relevant position of that terminal or vacant terminal position shall preferably be located on the matrix diagonal nearest to the visual identification of terminal A01.

12 - The tip of terminal may be pointed or have a radius or chamfer.

13 - The clearance between two metalized areas on the surface of the package shall be 0,51 mm

14 - Indicate the original dimensions.

	PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH OUTLINE FAMILY	Date: 2003
	60191 IEC I – 166E-h	

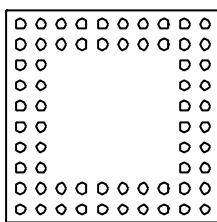


Fig.1

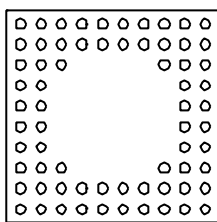


Fig.2

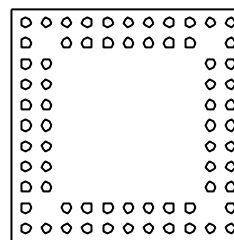


Fig.3

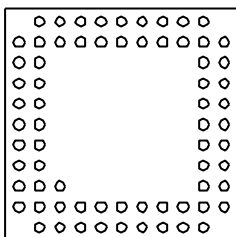


Fig.4

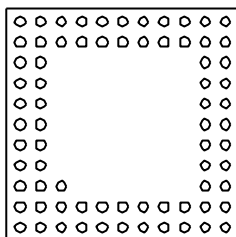


Fig.5

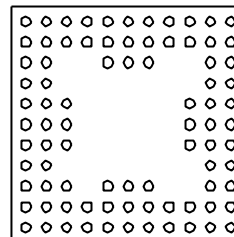


Fig.6

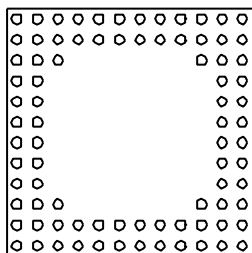


Fig.7

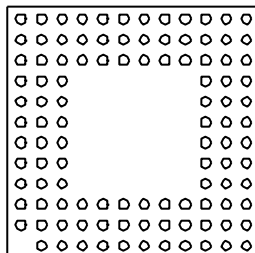


Fig.8

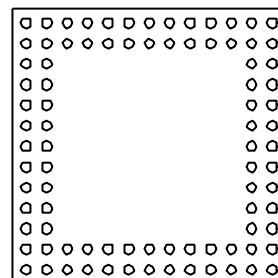


Fig.9

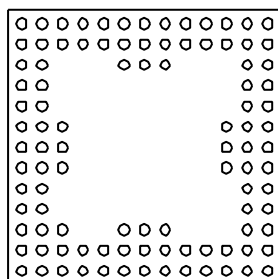


Fig.10

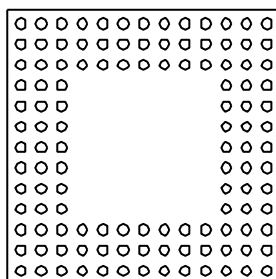


Fig.11

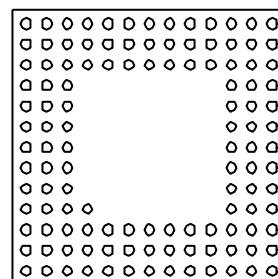
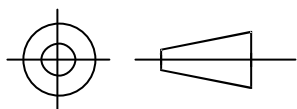


Fig.12



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

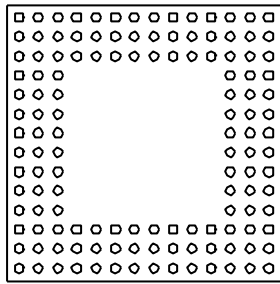


Fig.13

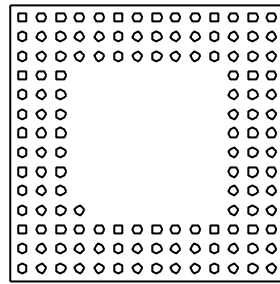


Fig.14

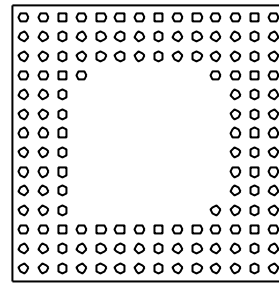


Fig.15

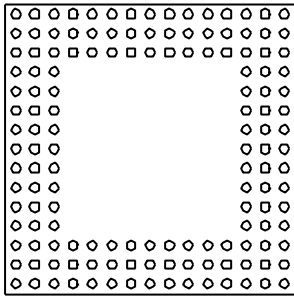


Fig.16

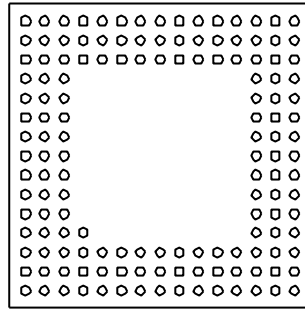


Fig.17

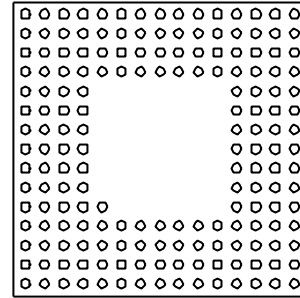


Fig.18

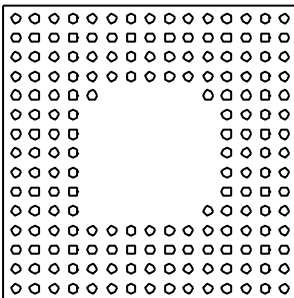


Fig.19

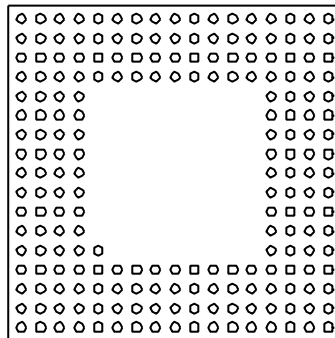


Fig.20

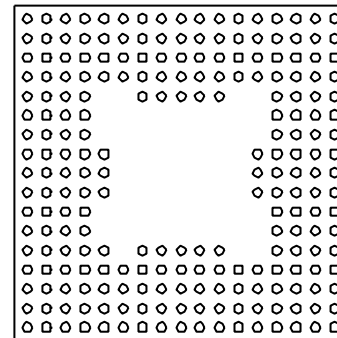


Fig.21

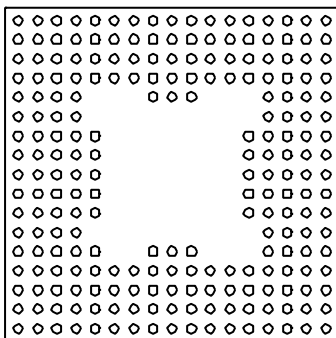


Fig.22

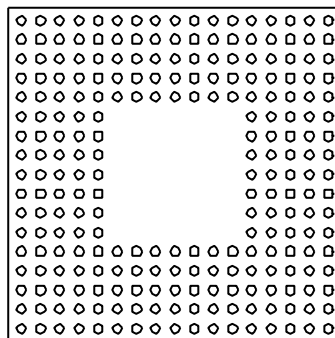


Fig.23

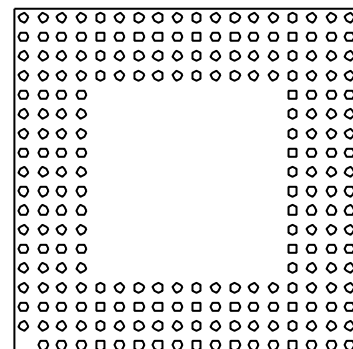
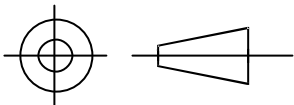


Fig.24



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

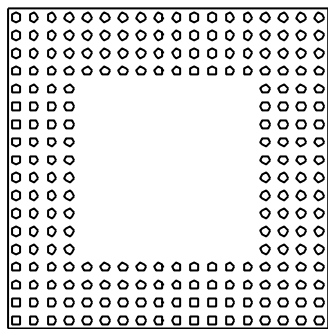


Fig.25

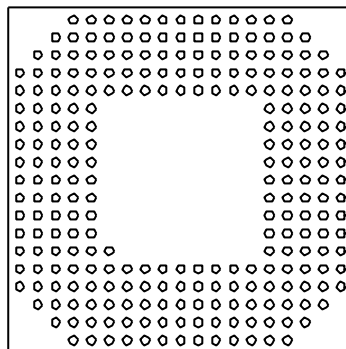


Fig.26

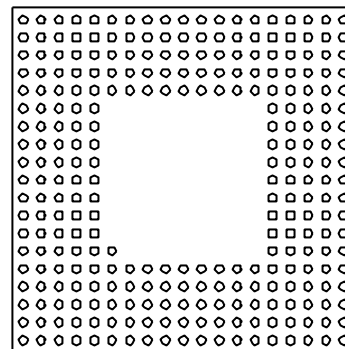


Fig.27

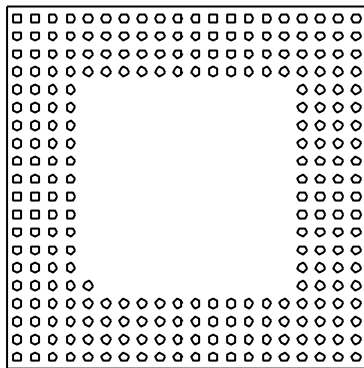


Fig.28

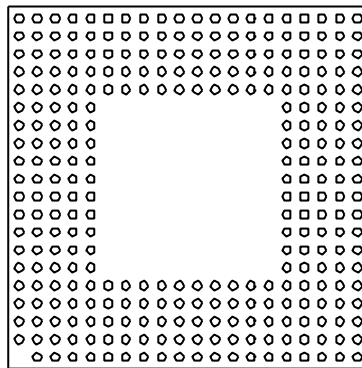


Fig.29

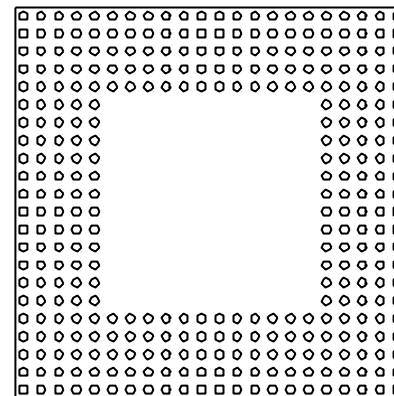
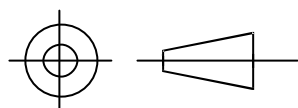


Fig.30



PIN GRID ARRAY 2,54 mm PITCH
OUTLINE FAMILY

Date: 2003

60191 IEC I – 166E-k

ISBN 2-8318-7096-8



9 782831 870960

ICS 31.080.01
